

1. Модуль паркету, що включає верхній шар, та містить на одній з бічних поверхонь елемент з'єднання у вигляді пазу, який відрізняється тим, що містить додатковий нижній шар, а бічна поверхня, що протилежна поверхні з пазом, додатково містить елемент з'єднання у вигляді шипу, при цьому нижня частина елемента з'єднання паз та верхня частина елемента з'єднання шип виконані із зсувом в протилежні сторони.
2. Модуль паркету за п. 1, який відрізняється тим, що елементи з'єднання при з'єднанні між собою окремих модулів паркету щільно прилягають один до одного лише в частині верхнього шару, а в інших частинах виконані з зазором.
3. Модуль паркету за п. 1, який відрізняється тим, що товщина верхнього слою паркетного модулю становить в діапазоні від 2 до 8 міліметрів.
4. Модуль паркету за п. 1, який відрізняється тим, що товщина нижнього слою паркетного модулю становить в діапазоні від 8 до 20 міліметрів.
5. Модуль паркету за п. 1, який відрізняється тим, що виступи нижньої частини елемента з'єднання паз та верхньої частини елемента з'єднання шип виконані в діапазоні від 15 до 30 міліметрів від внутрішньої грані пазу та від нижньої грані шипу відповідно.
6. Модуль паркету за п. 5, який відрізняється тим, що виступ верхньої частини елемента з'єднання шип менше виступу нижньої частини елемента з'єднання паз на величину зазору.
7. Модуль паркету за п. 1, який відрізняється тим, що верхній шар виконаний з дерева.